

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML4

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	363		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
		33	L2	
B-RS-FR4-DS-1.55mm-035+035-TG150-HF	50200664	1480		4
		33	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	363		5
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	7

Dicke nach Verpressen

B00: 2290 µm

Tol+: 240 µm

Tol-: 240 µm

Dmax: 2530 µm

Dmin: 2050 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+: 0 µm

Tol-: 0 µm

Dmax: 0 µm

Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 2400 µm

Tol+: 240 µm

Tol-: 240 µm

Dmax: 2640 µm

Dmin: 2160 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal: 2308 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik